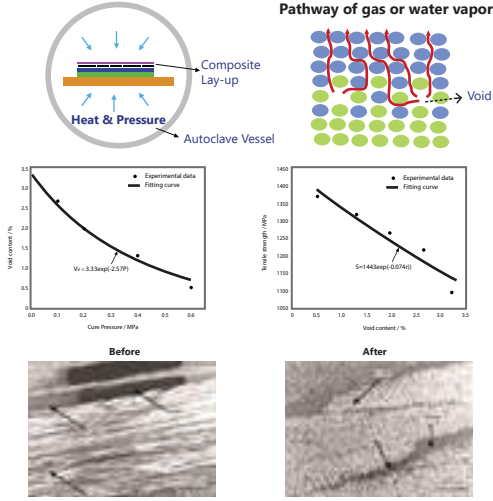


HIGH PRESSURE OVEN

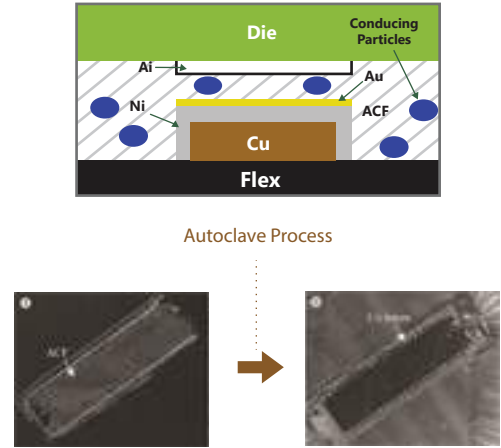
등방성으로 가압되는 설비로 적층 성형공정에 적용되며 터치패널, 핸드폰 액정, 모니터용 LCD나 PDP등 유리기판에 필름을 붙이는 공정이나 반도체 패키징 공정에 사용됩니다.

Removal of Void (Film, Carbon/Epoxy)



Ref. J. Mater. Sci. Technol., 27(1), (2011) 69-73

Laminated Films (Anisotropic Conductive Film, Flip Chip)



Ref. Mater. Sci. Eng. B., 98, (2003) 255-264

온도
(200°C)

경화공정 가능

압력
[60 kg/cm²]

등방성 가압
[점착강도 및 밀도증가]

